

2024年3月期決算説明会

2024年5月8日
株式会社MARUWA (5344)

ご注意事項

本資料は投資勧誘を目的とするものではありません。
将来の見込みに関する事項については、現時点で入手可能な情報に基づいており、
将来の事象により変動する可能性があり、内容を保証するものではありません。

1. 決算概要

(金額：百万円)

	当期 (2024年3月期)		前期 (2023年3月期)
		対前期増減	
売上	61,564	+ 4.7%	58,804
営業利益	19,801	△1.7%	20,142
経常利益	21,121	△0.3%	21,187
純利益	15,216	+ 1.3%	15,020

2. 市場別売上高

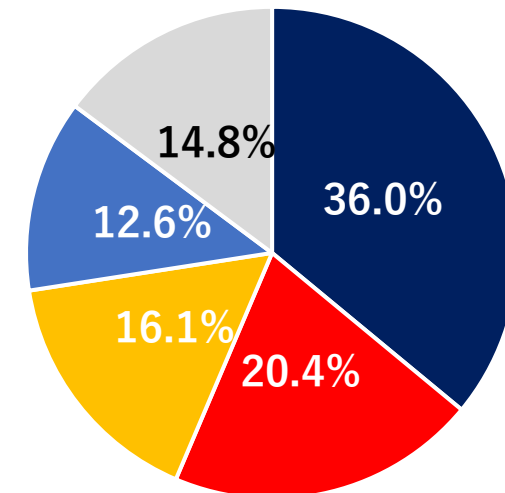
■市場別売上高

(金額：億円)

	当期	対前期増減	前期	直前四半期比 4Q/3Q
情報通信	211.7	+0%	211.6	△4.6%
車載	133.0	+10.9%	119.9	△4.2%
半導体	106.8	+12.5%	94.9	+5.9%
産業機器	80.6	+8.5%	74.3	△19.9%
照明	83.3	△4.3%	87.0	13.4%

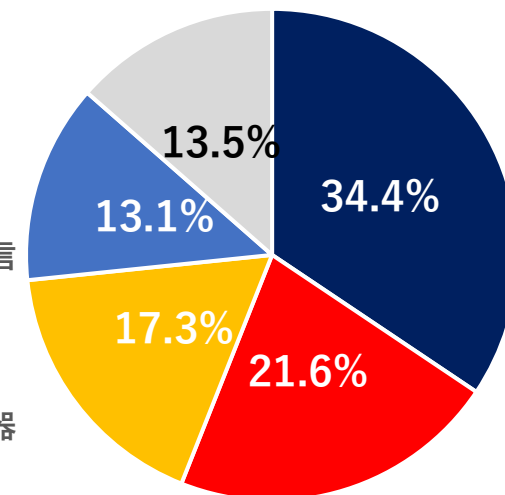
■構成比

前期累計

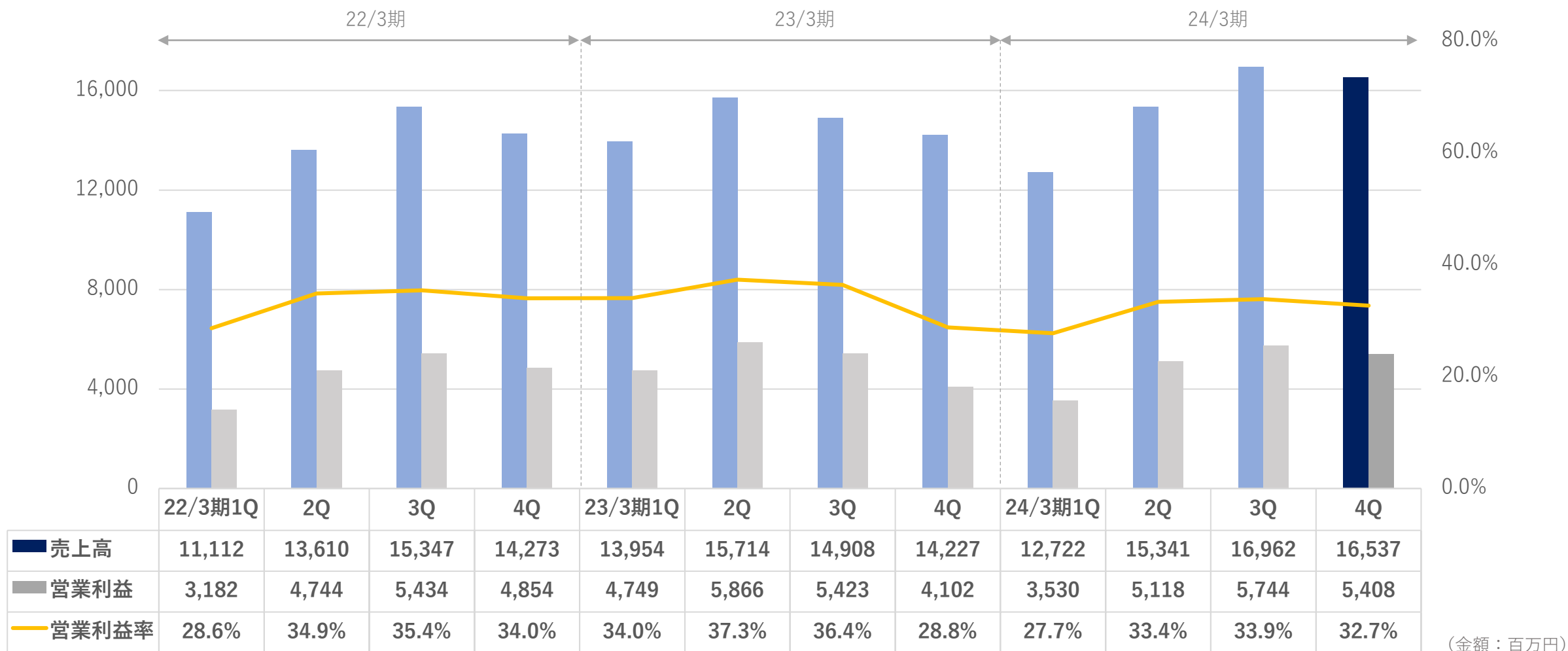


当期累計

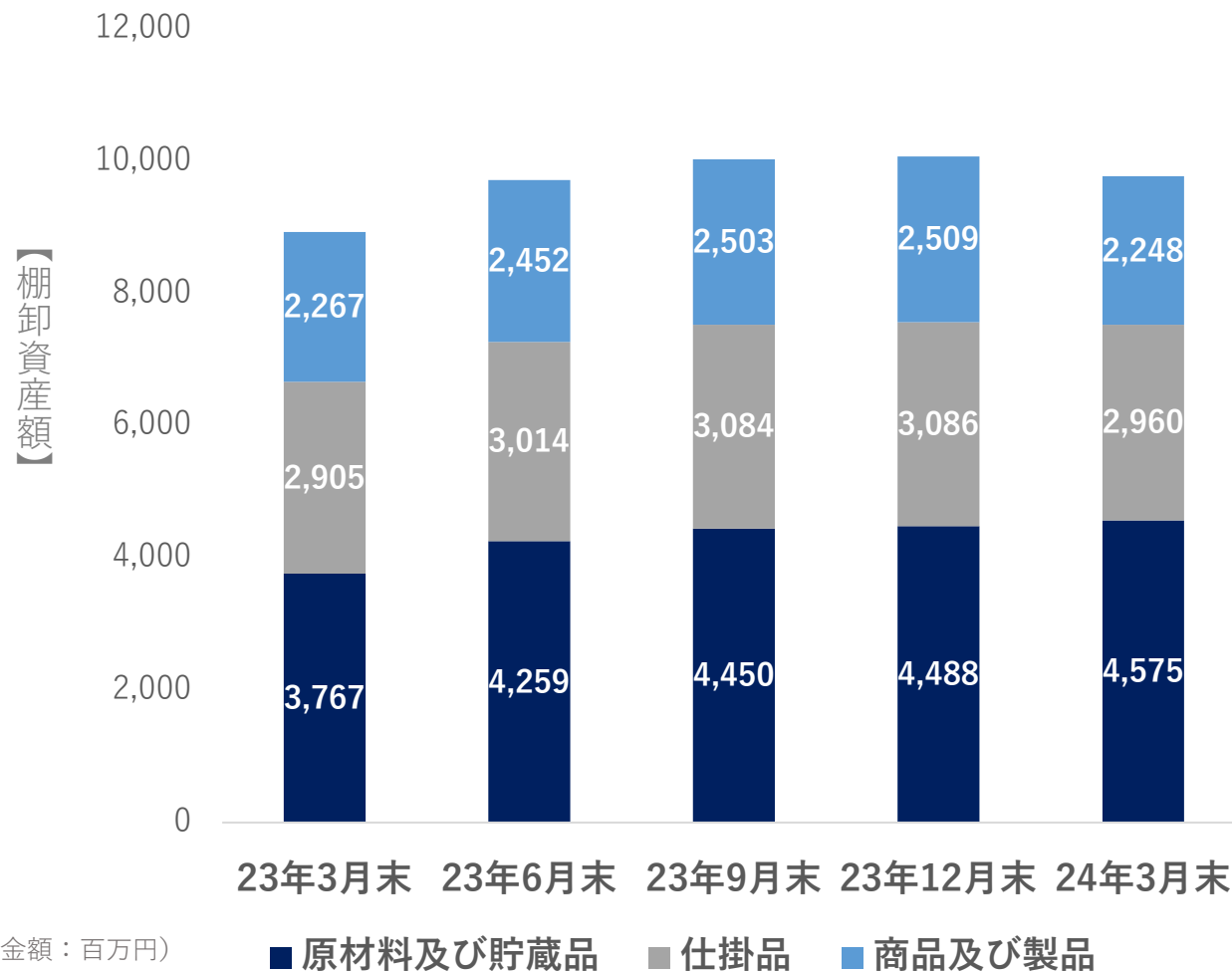
- 情報通信
- 車載
- 半導体
- 産業機器
- 照明



3. 四半期業績



4. 棚卸資産



- 原材料及び貯蔵品の増加傾向が続いているが、戦略的な原材料の確保を引き続き実施していることによるもの
- 棚卸資産総額は、正常の範囲内で運用

5. 25年3月期業績見通し

	通期		上期		下期	
	対前期増減		対前期増減		対前期増減	
売上高	70,300	+14.2%	30,800	+9.8%	39,500	+17.9%
営業利益	23,000	+16.2%	10,000	+15.6%	13,000	+16.6%

※為替前提 1ドル=147円

※「経常利益」、「親会社に帰属する当期純利益」については、主に為替要因により変動することが想定され、現時点で為替動向が不透明なため、見通しの記載を省略しております。

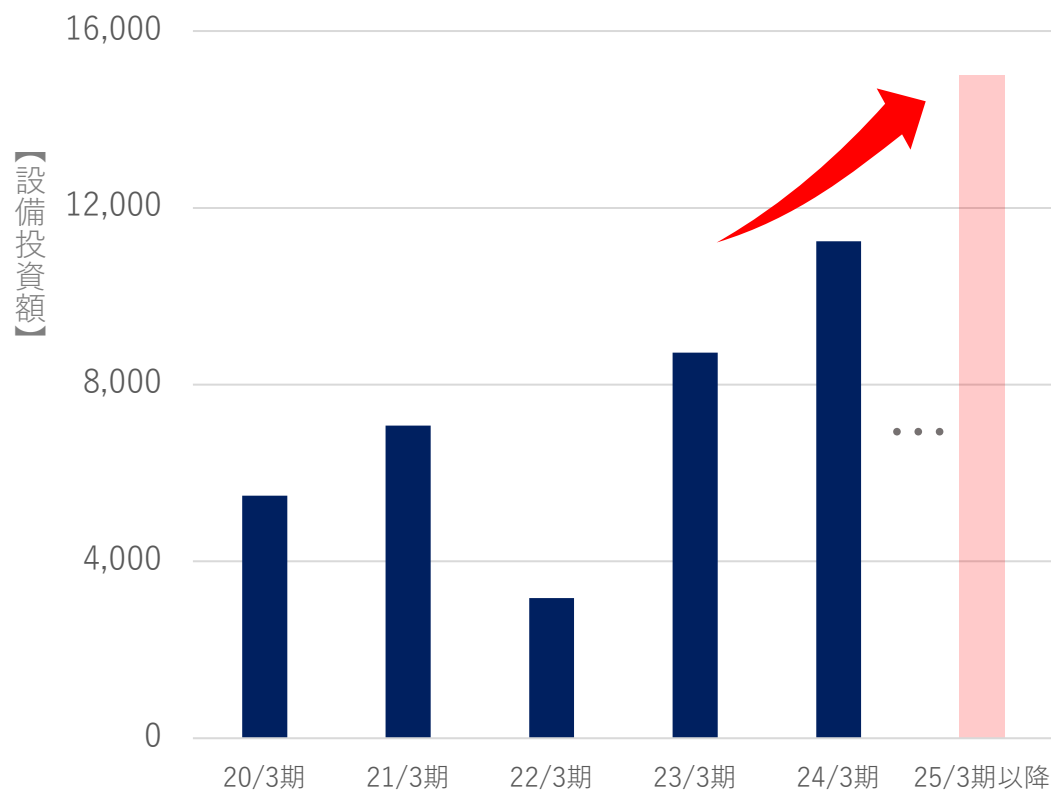
6. 今後の見通し（市場動向・当社動向）

市場	状況
情報通信	<ul style="list-style-type: none"> 中国通信市場の回復は不透明。 次世代高速通信関連の新規市場向けは、引き続き強い需要。
車載	<ul style="list-style-type: none"> BEV向けで成長率鈍化の見通しの一方、HV及びPHV向けで需要が拡大する見通し。 自動化等により、収益力の一段の強化に注力。
半導体製造装置	<ul style="list-style-type: none"> 生成AI需要や各国の半導体支援策を背景とした業績拡大を見込む。
産業機器	<ul style="list-style-type: none"> 中国関連は先行き不透明も、パワー半導体向けの中長期的な成長に向け、差別化を強化。
照明	<ul style="list-style-type: none"> 富裕層をターゲットに、高付加価値照明に注力。

7. 設備投資額・減価償却費

■設備投資額

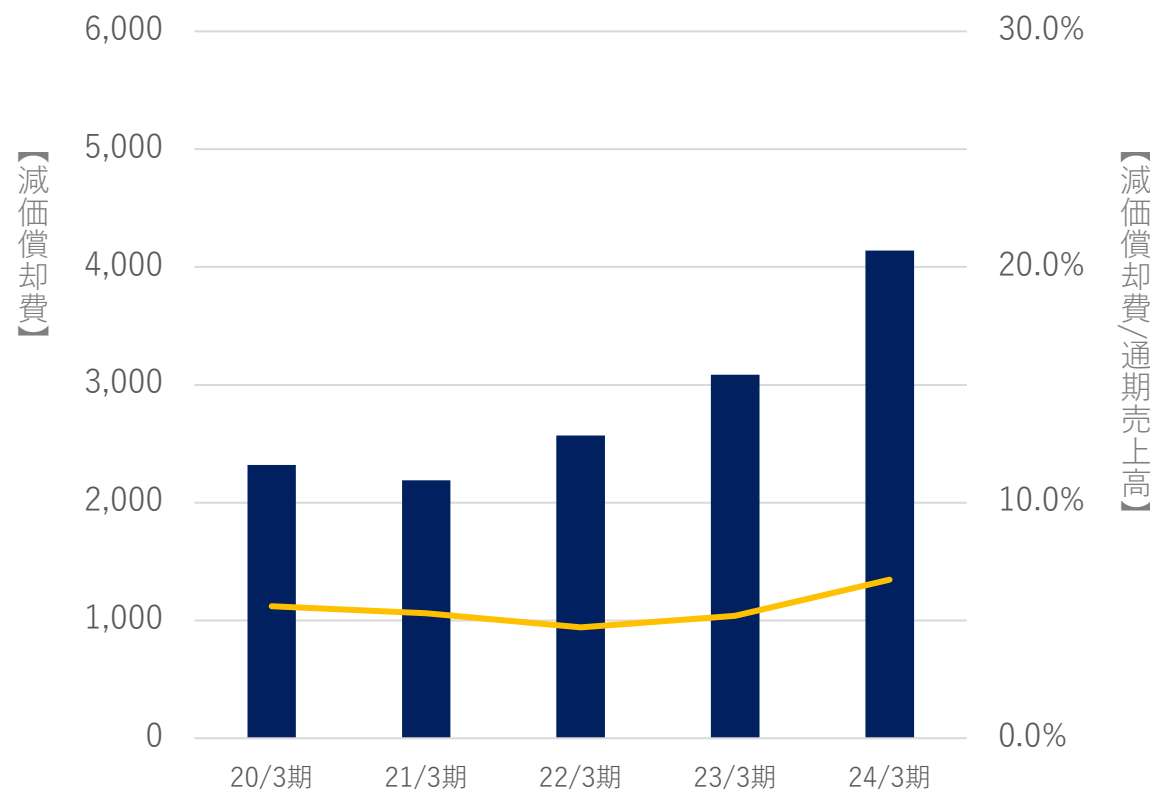
中長期での成長に向けた新工場・新棟への投資、生産性向上・品質向上のための自動化投資



(金額：百万円)

■減価償却費・対売上割合

競争力・生産性の向上に着実につなげていく



8. 新工場

市場	工場	目的	スケジュール
次世代・新規 (通信)	瀬戸工場	新規立ち上げ	量産開始
	NEW 瀬戸工場 研究棟	研究開発	26年3月期竣工予定
xEV (車載)	土岐工場 新棟①	増産 (セラミック基板)	量産開始
	土岐工場 新棟②	増産 (セラミック基板)	26年3月期竣工予定
半導体 製造装置	三春工場 新棟①	増産 (石英)	26年3月期竣工予定
	NEW 三春工場 新棟②	増産 (石英)	(未定)
	NEW 土岐工場 新棟	新製品対応 (高純度SiC焼結体)	26年3月期竣工予定

9. 株主還元

■ 配当

今期は12期連続増配の予定となり、今後も安定した連続増配を目指す

1株当たり配当額
年間 94 円

